
ASIC制造服务合约

(合同编号: SZMNI2024)

深圳理工大学 (筹)

与

深圳市微纳集成电路与系统应用研究院

2024年 月 日

ASIC制造服务合约

深圳理工大学（筹）（以下简称"甲方"）委托深圳市微纳集成电路与系统应用研究院（以下简称"乙方"）就甲方已自行开发完成之特定集成电路产品，提供制造服务，经双方议定条款如下：

第一条：制造服务目标（以下简称"本产品"）

本产品甲方描述之代号：MEISHAV100

本产品乙方描述之代号：福理项目611101

第二条：制造服务内容

乙方同意接受甲方之委托依本合约提供制造服务，服务内容及相关时程如双方分工明细说明SOW【(Statement of Work or Co-work Matrix)附件一】所载，双方知悉并同意该时程仅系预估性质，后续将视实际执行情况调整，由双方讨论协商后并以书面确认最终时程。

第三条：规格

乙方将按照甲方之项目基本规格(附件一)提供报价(附件二)并依此进行制造服务，乙方于委制光罩前，应经甲方签署Tape Out Sign-off Form(确认书)同意。

第四条：样品提供与认可(Acceptance)

1. 经过双方确认，并于甲方签回Tape Out Sign-off Form后，乙方依照生产时程(通常约为14周，但实际时程须依乙方实际生产情形调整)，提供甲方报价单中对应的工程样品 (以下简称"样品")。

第五条：制造服务费及其付款方式

1. 制造服务费(NRE)（含增值税）：48,9000 元整【即附件二：《微纳研究院 ASIC 制造服务项目报价单》中 Price所载之数额】。
2. 付款方式：甲方获取MPW制造工艺文件（PDK）前及所预定MPW班车排期前两个月完成全额付款。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：中国银行深圳科技园支行

账户：深圳市微纳集成电路与系统应用研究院

帐号：752360192634

地址：深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 6 楼

第六条：风险产品

甲方于收到样品后，未符合代工厂定义之量产阶段，甲方如欲速订购本产品(在此情形下，乙方所供应之产品定义为"风险产品")，应与乙方另行签署ASIC Pre-Production Agreement文件，作为乙方供应风险产品之相关责任免除依据。

第七条：本产品之量产制造服务（如无量产需求，则此条不适用）

1. 甲方于达到代工厂定义之量产阶段时，甲方应向乙方以订单方式订购本产品(在此情形下，乙方所供应之产品定义为"量产产品")。该量产产品之规格条件、价格、功能、交付日期、交货条件、付款方式以及数量，应载明于该份订单中。量产产品如有未符合上述之规格条件之情形，双方同意，乙方之全部责任为乙方应以等量之新品于次批产品出货时补足之。
2. 除本合约另有约定外，乙方应于甲方发出订单后七个工作日内向甲方确认，乙方逾期未向甲方确认者，视为乙方接受甲方订单，订单成立后，甲方不得取消订单。乙方应尽商业上合理努力，交付甲方符合订单所载之量产产品。唯双方了解并同意甲方订单上所载之交付日期及数量为双方所约定，乙方应尽商业上合理努力安排以符合甲方期待，但仍存有非乙方所能控制之因素，而有调整订单内容之必要；如有迟延之虞时，乙方应立即通知甲方、如于订单期限届至前仅能交付部分量产产品，除双方同意另行安排交付者外，乙方应于通知甲方后交付该部分量产产品，双方同意，乙方之全部责任为乙方应以等量之新品于次批产品出货时补足之。
3. 量产产品价格应载明于订单上，但双方另有约定者，不在此限。
4. 付款条件：甲方应以电汇付款方式支付该次订单所载之量产产品货款，付款期限以该订单所载之付款条件为准，但双方另有约定者，从其约定。
5. 双方同意量产产品之所有权及风险承担，于甲方完成验收量产产品之时起，归属或转移至甲方。
6. 如因非可归责于乙方事由，例如量产产品停产(EOL)、乙方供货商临时告知停产或变更等突发情形或其他不可抗力事由，导致乙方无法履行供应或承制该量产产品之

规定，乙方应于知悉之时起，一个月内以书面通知甲方进行最后购买(Last Buy)，并由双方协商确认甲方最后购买之最低采购量以及最后提货期限。

7. 本合约量产产品之保固期为自乙方出货日起算一年，但乙方依据甲方之指示(1)于未达成品阶段前暂停生产(“在制品”)，于客户通知暂停生产时起算，在制品之保固期为十八个月；(2)延后出货时，本产品之保固期自制造完成日起算一年。若因甲方之指示延后出货，甲方同意并支付相关保管费用。
8. 关于量产产品之交付，各分批出货期限及数量，由双方协议或采购订单定之，但每批订购数量以25片 wafer为单位。

第八条： 交货

1. 交货地点为甲方指定的收货地址。
2. 出货包装依乙方一般出货包装标准。
3. 包装方式按国家相关标准或主管部门的规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护加工物不受损的包装方式。乙方需确保包装质量，在甲方收货后的保管、装卸、拆包过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的加工物损害，由乙方负直接责任。
4. 验收：甲方应于收到产品后当场先进行验收，验收合格（验收标准为符合foundry出厂标准且外观无明显损坏）后再确认签收并于2个工作日内回寄签收单，若验收不合格的，甲方应及时通知乙方，乙方应自收到甲方通知后5个工作日内给出处理方式或者接受退货，若不接受的，乙方应全力配合甲方向foundry争取合理的解决方案。

第九条： 光罩、技术及相关资料之权利

1. 甲方同意仅透过乙方提供流片服务(tape-out)生产量产产品前提下，双方同意因生产供应服务合约所产生之本产品光罩所有权及甲方原有和因履行本合约而新产生的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、集成电路布图设计、技术秘密等）归甲方单独所有，双方于本合约签订前已拥有或已产生之知识产权仍由双方各自所保有。乙方未经甲方事前书面同意，不得使用此光罩为自己或任何第三人生产或委托生产本产品。
2. 本产品光罩由乙方保管，光罩所有权归甲方，根据合约双方约定，甲方授予乙方光罩专属生产权，未经双方协商同意，甲方不会自行转让乙方的生产权。

3. 双方同意本合约项下所有产品，包括但不限于样品、量产产品（若有），乙方非经甲方事先书面同意，不得将本产品出售予任何任何第三者，但经甲方指定的除外（即若乙方接到甲方书面通知和授权，可将本合约项下产品出售予甲方指定的任何乙方无异议的第三方，乙方应当履行和配合）。

第十条：保密责任

1. 双方因业务联系或本合约之履行而知悉或持有对方标示为机密或性质上属机密之数据或文件，均应严格保密，非经对方事前书面同意，不得泄漏予任何第三人，双方并应负责要求其员工（含退、离职人员）遵守。前述数据或文件应设立专档，由专人管理，仅供执行本合约之相关人员在为履行本合约之目的范围内使用。
2. 未经乙方事前书面同意，甲方不得泄漏、交付乙方之IP数据及信息(包括但不限于乙方自第三人授权之IP)予任何第三人或使第三人知悉其内容之全部或一部分。
3. 保密责任期限自接受或知悉机密数据或文件之日起10年内有效。本项保密责任，不因本合约之终止或解除而免除，但得经双方同意，以书面延展之。
4. 若一方违反本条规定，并经法院判定败诉确定，应担负全部民、刑事责任及一切诉讼相关费用。
5. 本保密条款不因本合约无效或终止而失效。

第十一条：知识产权

1. 除本合约第十条第1.项前段规定外，有关本合约签订前双方所有之知识产权归属于该各方所有。
2. 双方约定，因履行本合约而新产生的技术服务成果及其知识产权均归属于甲方。乙方向甲方提交的因履行本合约而新产生的技术服务成果及其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、商标权、技术秘密、技术成果等），由甲方单独所有。未经甲方书面同意，乙方不得再使用本合约项下的新产生的技术服务成果，也不得提供或披露给第三方使用，否则由此给甲方造成的损失，乙方应当承担赔偿责任。
3. 乙方将保护甲方免于承担因使用本合约项下乙方提供的技术、产品或技术服务成果而侵犯或者被指控侵犯任何第三方知识产权（包括但不限于任何专利权、专有技术、著作权、商标专用权以及商业秘密等）导致甲方被起诉以及被索赔的，乙方应自行负责处理，且与此相关的全部赔偿责任及损失（包括但不限于诉讼费/仲

裁费、律师费、执行费、鉴定费)等均由乙方承担。若仅因乙方原因导致甲方利益受到侵害的,经双方友好协商,甲方有权要求乙方赔偿相应的合理损失。

第十二条: 出口法规遵循

双方均应自行承担因遵守与本合约相关之具管辖权之法律、法规和命令所衍生之费用。双方理解任何一方均应遵循相关各国相关出口管制、禁运等法规。

第十三条: 不可抗力

本合约有效期内,如因天灾地变或非人力所能抗拒之事由,包括但不限于发生战争(不论是否宣战)或遇火灾、水灾、罢工、动乱、政府禁令限制、突发重大疫情等不可抗力或因事变或其他非可归责于甲乙双方之事由,致任何一方无法履行本合约时所造成之损害,任一方皆不得向他方要求赔偿或退还已依约给付之金额,但若存在预付金额或未提供服务或商品之金额的,乙方应当自不可抗力发生之日起一个月内将可返还金额返还给甲方。

第十四条: 保证

乙方仅就量产产品之制造服务为保证,且保证之范围、期间、对象系依据乙方委托之晶圆代工厂对量产产品所为之相同范围、期间、对象之保证,除前述所为保证外,乙方不就该事项为任何直接、间接、明示、暗示之保证。

第十五条: 合约效力及终止

1. 本合约自生效日起生效,至甲方停止订购本产品满三年之日起终止,乙方需于合约终止前1个月以邮件形式正式通知甲方,但得经双方书面同意后另订书面延展之。合约终止时,经甲方书面同意后,乙方将启动产品报废作业,即与甲方确认是否将本产品的成品、半成品及光罩报废。甲方不同意报废若还需要继续生产则需要给出预计生产时间,产品闲置期间,产生之相关保管及品质费用由甲方承担。
2. 若因甲方单方原因,无正当理由不依约定时间及金额付款,经乙方正式书面通知或邮件催告后一个月内甲方确认回复无法履行时,合约视为立即终止,乙方有权要求甲方自约定支付期限届满之7日起,则每逾期一日,按照应付未付金额的万分之二支付逾期违约金。

3. 乙方应按本合约附件一约定的时间提交设计成果，及时与甲方沟通项目进度，及时完成甲方设计。若仅由于乙方原因导致其本项目流片阶段的交付时间延期，则乙方应自约定交付期限届满之7日起向甲方支付违约金，则每逾期一日，按相关逾期阶段所对应的服务费金额的万分之二计算违约金，该笔违约金在甲方支付给乙方的款项中进行扣除。若由于乙方原因造成项目流片阶段的交付延期超过两个月以上，甲方有权单方面终止本合同的执行，停止后续款项的支付，并有权要求乙方按照本合同总金额的10%支付违约金。乙方提交的设计成果应符合甲方要求，若流片回片测试因乙方原因造成甲方芯片产品工作不正常（包括但不限于：芯片不工作；芯片电气参数不符规格要求；芯片可靠性指标不符规格要求）。乙方须延长服务至甲方产品可正常工作，且乙方需按照本合同总金额的10%支付违约金。甲方如于制造服务进行中，欲终止本合约，需结清相应的制造服务费用。
4. 甲乙双方不得无故终止或解除合同。因乙方原因造成项目终止的，甲方有权单方面终止本合同的执行，有权向乙方要求退还相应的未完成工作的费用并有权要求乙方对于甲方因此造成的损失进行合理赔偿。任何一方对于他方之营业损失，间接经济损失或附随损害不负赔偿责任。

第十六条：准据法及仲裁机构

本合约适用于中华人民共和国法律，并排除冲突规则的适用。因本合约引起的或者与本合约相关的争议，双方应协商解决，如无法协商解决，一方可将争议提交原告所在地人民法院提起诉讼解决。

第十七条：本合约若有未尽事宜，应由双方共同协议以书面修正增补之，或依中华人民共和国有关法令规范之。

第十八条：本合约自双方均盖章之日起生效。

第十九条：本合约之附件，均视同本合约之一部份。本合约一式二份，由双方各执一份。

附件清单：

附件一：《ASIC制造服务项目SOW》

附件二：《微纳研究院 ASIC制造服务项目报价单》

[以下空白，接签名页]

(本页无正文，为甲、乙方《ASIC制造服务合约》签署页)

甲 方：深圳理工大学（筹）

代表（理）人：

地 址：

日 期：

乙 方：深圳市微纳集成电路与系统应用研究院

代表（理）人：

地 址：深圳市福田区中康路136号深圳新一代产业园4栋6楼

日 期：



附件一：《ASIC制造服务项目SOW》

ASIC 制造服务项目 SOW

一、项目概述

甲方已自行开发完成特定集成电路产品，委托乙方协助对接和提供MPW制造服务；双方知悉并同意该时程仅系预估性质，后续可视实际执行情况调整，由双方讨论协商后并以书面确认最终时程。

二、项目服务范围和分工

- 1、甲方设计完成后，提供正式GDSII文件给乙方；
- 2、乙方协助甲方预定UMC的MPW班车，并跟进项目，流成功后提供样片Die（未封装）。
- 3、本项目为MPW服务，不包括量产相关事宜。

三、项目计划时间表

- 1、签订合同后，双方协商制定项目计划时间表；
- 2、甲方签署Tape Out Sign-off Form(确认书)同意后，乙方依照生产时程(通常约为14周)完成样片Die（未封装）交付。

四、其他事项

无

附件二：《微纳研究院 ASIC制造服务项目报价单》



Purchase Information

NO.: 611101

报价单发出日期: June 12, 2014
 供货单位: 深圳市微纳集成电路与系统应用研究院
 服务要求: MPW 制造服务
 项目代号: 福理项目 611101



备注:

- NRE 费用为人民币价格, 总额: 肆拾捌万玖仟元整 (含 6%税)。NRE 是基于 UMC 40nm process, 占用 1seat, 含 60 颗芯片, 详见下表。

项目	明细	人民币合计
UMC 40nm process	(1) MPW 班车预定; (2) 占用 1seat (size: 4mm*4mm); (3) 60 颗样片 Die (未封装)	¥ 48,9000.00

2. 付款的时间和方式:

- MPW 费用在 MPW 排期前两个月全款预付, 该预付费用若没有赶上班车, 可以平移到下一期, 也可以转 UMC 其它项目。



委托方:

深圳理工大学 (筹)

联系人: 黄东航
 联系电话: 13556318731

被委托方:

深圳市微纳集成电路与系统应用研究院

联系人: 何越文
 联系电话: 18923855691

Note: 收到以上订单, 请尽快确认并书面回复 (Please confirm & reply soon when receive the PO.)

附件: MPW 流片服务工艺要求

Product Information						
Product Information*	Foundry	UMC	Process	40nm	Poly/Metal Stack	IP8M



Process Type	G	Core Voltage (V)	0.8	Mask layer no	7
IO Voltage (V)	1.8	Max Operation Frequency (MHz)	850	Estimate Die Size (mm*mm)	6
Temperature Range	-40°C to 125°C	Max IO Frequency (MHz)	50	Max Test Frequency (MHz)	850
Gate Count (-2 inputs NAND)	20 million	Critical Path Frequency (MHz)	800	Other Memory Size (M bits)	7
Signal IO Count	40	RAM/ROM Size (M bits)	1000Mbit + 65536bit		

